^{03,13} Термоэлектрические свойства тонкопленочных композитов Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C

© Ю.Е. Калинин, В.А. Макагонов, А.В. Ситников

Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия

E-mail: vlad_makagonov@mail.ru

(Поступила в Редакцию 14 апреля 2015 г.)

Синтезированы тонкопленочные нанокомпозиты полупроводникового твердого раствора Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1} в матрице углерода. Исследования низкотемпературных зависимостей удельного электрического сопротивления и термоэдс в области температур 77–300 К показали последовательную смену доминирующих механизмов проводимости: прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям, лежащим в узкой полосе энергий вблизи уровня Ферми, прыжковая проводимость по ближайшим соседям и прыжковый электроперенос, связанный с носителями, возбужденными в локализованные состояния у краев зон.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-08-97533) и Минобрнауки РФ (соглашение № 14.574.21.0083).

1. Введение

Твердотельные термоэлектрические преобразователи энергии имеют ряд преимуществ перед традиционными электрическими генераторами и охладителями. К ним можно отнести простоту конструкции, отсутствие движущихся частей, бесшумность работы, высокуя надежность, возможность миниатюризации без потери эффективности [1-3]. В последние годы наряду с традиционной технологией изготовления термоэлектрических модулей, по которой термоэлементы выполняют из объемного термоэлектрического материала, развивается так называемая тонкопленочная технология, когда элементы получают с помощью методов тонкопленочного нанесения различными способами. Данная технология имеет ряд преимуществ перед традиционной: совместимость с технологиями производства полупроводниковых приборов, возможность миниатюризации термоэлектрических устройств (актуально для нужд опто- и микроэлектроники, где необходимо термоэлектрическое охлаждение), улучшенные показатели холодильной или генераторной мощности по сравнению с традиционными термоэлектрическими модулями [4,5].

Основными факторами, сдерживающими широкое использование термоэлектрических устройств, базирующихся в основном на теллуридах висмута, сурьмы, свинца и селена, являются низкая термоэлектрическая добротность и высокая стоимость исходного сырья. Эффективность термоэлектрического преобразования $ZT = ((\sigma \alpha^2)/\chi)T$ определяется электропроводностью σ , термоэдс α , теплопроводностью χ материала термоэлемента и температурой T источника тепловой энергии [6].

Для получения материала с высокой термоэлектрической добротностью необходимо вещество, обладающее высокой проводимостью полупроводникового типа, высоким коэффициентом Зеебека и низкой (преимущественно решеточной) теплопроводностью. Следовательно, основная задача состоит в одновременной оптимизации трех указанных параметров, причем механизмы, определяющие понижение электрического сопротивления и повышение коэффициента термоэдс, не должны компенсировать друг друга.

Повысить добротность таких систем можно путем увеличения коэффициента Зеебека либо электрической проводимости или путем снижения решеточной теплопроводности. Для повышения ZT в халькогенидах была предпринята попытка создать твердый раствор в системе SnTe-SnSe (20%), что позволило получить $ZT \sim 0.45$ при 700 K [7].

Известно достаточно много теоретических работ, например [8–10], в которых показано, что переход к наноструктурированному материалу должен увеличивать термоэлектрическую эффективность. В качестве механизмов такого увеличения рассматриваются рассеяние фононов на границах наночастиц [8], приводящее к снижению решеточной теплопроводности, и квантовое туннелирование носителей заряда через вакуумные либо диэлектрические зазоры между частицами, приводящее к росту электропроводности и термоэдс, а следовательно, и фактора мощности [9,10]. В этих работах показано, что наилучшие значения безразмерной термоэлектрической эффективности наноструктурированного материала на основе теллурида висмута должны достигать 3.5–3.6.

Целью настоящей работы являются синтез новых тонкопленочных композитов твердых растворов (Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}) с углеродом и исследование их структуры, электрических и термоэлектрических свойств.



Рис. 1. Дифрактограммы тонких пленок образцов системы Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-С (около кривых указано содержание углерода в at.%) (*a*), микрофотография (*b*) и электронная дифракция (*c*) образца с содержанием углерода 17 at.%.

2. Методика эксперимента

Для получения образцов применялся метод ионнолучевого распыления, являющийся разновидностью метода ионно-плазменного распыления, при котором ионы инертного газа из независимого источника направлялись потоком высокой энергии на мишень. Поскольку данный источник ионов не связан с объектом распыления, он позволяет распылять металлы и сплавы, полупроводники и диэлектрики. При получении исследуемых композитов в качестве материала матрицы использован углерод. Компоненты твердого раствора Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1} не образуют карбидов или твердых растворов с углеродом, поэтому при совместном осаждении полупроводника (Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}) и углерода в условиях фазового расслоения наибо-

3 Физика твердого тела, 2015, том 57, вып. 10

лее выгодно образование пленок с гранулированной структурой.

В качестве подложек были использованы ситалловые пластины CT-50 размером 60×48 mm для электрических и рентгеновских исследований; монокристаллы поваренной соли для электронной просвечивающей микроскопии. Благодаря использованию оригинальной составной мишени, представляющей собой полупроводниковое основание размером 270×80 mm с закрепленными на нем навесками углерода, на подложке в одном технологическом цикле распыления можно получать образцы с широким диапазоном концентраций углерода. Объектами исследований были тонкопленочные образцы Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C, полученные методом ионнолучевого распыления составной мишени в атмосфере аргона ($P_{\rm Ar} = 3.6 \cdot 10^{-4}$ Torr) с последующей конденса-

цией на подложки. Толщина полученных пленок измерялась на интерферометре МИИ-4 и менялась от 2.5 до 3 μ m.

Зависимость термоэдс композитов от концентрации углерода получена посредством измерения каждого образца при комнатной температуре методом горячего зонда. Материалом холодного и горячего зондов служила серебряная проволока чистотой 99.999%. Температурные зависимости термоэдс измерены по дифференциальной методике в диапазоне температур 77–300 К. Для измерения использовались напыленные на ситалловую подложку образцы пленок композитов шириной 3 mm и длиной 40–60 mm, вдоль которых создавался температурный градиент. Относительная погрешность измерения значений термоэдс составила не более 3%.

Температурные и концентрационные зависимости удельного электрического сопротивления были измерены двухзондовым методом на постоянном токе при помощи универсального цифрового мультиметра B7-78/1. Относительная погрешность измерения электрического сопротивления исследуемых гранулированных композитов не превышала 2%.

Химический состав образцов определялся с помощью энергодисперсионной приставки INCA X-MAX (Oxford Instruments) к растровому электронному микроскопу CARL ZEISS EVO MA 10. Структура исследовалась методом рентгеновской дифрактометрии на приборе Bruker D2 Phaser, обработка результатов осуществлялась с помощью программных средств Bruker DIFFRAC EVA 3.0 и TOPAS 4.2. Фотографии морфологии образцов и картины электронной дифракции были получены на просвечивающем электронном микроскопе CARL ZEISS LIBRA 120.

Анализ структуры и морфологии образцов показал, что тонкие пленки $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C$ являются композитами, в которых кристаллики твердого раствора $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}$ с размером 1.9-3.8 nm хаотически расположены в матрице аморфного углерода, при этом с уменьшением доли углерода размеры включений увеличиваются (рис. 1).

Кристаллическая структура включений Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1} ромбоэдрическая с пространственной группой $D_{3d}^5(R\bar{3}m)$ и параметрами решетки a = 4.138 Å, c = 29.466 Å. Из картин рентгеновской дифракции также следует, что в пленках с концентрацией углерода менее 12 at.% проявляется текстура (205).

Таким образом, добавление углерода в композиты Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-С приводит, с одной стороны, к уменьшению размера кристаллитов, а с другой — к подавлению анизотропии роста кристаллитов в пленке.

3. Экспериментальные результаты

На рис. 2 приведены зависимости удельного электрического сопротивления и термоэдс полученной системы



Рис. 2. Зависимости удельного электрического сопротивления (a) и термоэдс (b) тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C от концентрации углерода.

от концентрации углерода, характерные для перколяционной системы с порогом протекания ~ 10.5 at.% С, в которой аморфный углерод выступает в роли матрицы. Знак термоэдс во всем исследованном диапазоне отрицательный, что свидетельствует о доминирующем влиянии электронов в переносе заряда. Следует отметить, что абсолютные значения как термоэдс, так и удельного электросопротивления выше, чем полученные в [11] для тонких пленок чистого теллурида висмута. Установленная закономерность может быть объяснена особенностями электропереноса, реализуемыми в данной гетерогенной системе.

Для определения механизмов электрической проводимости в композитах $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C$ были исследованы температурные зависимости электрического сопротивления и термоэдс в интервале температур 77–300 K (рис. 3, *a* и *b*). С увеличением температуры наблюдается уменьшение электрического сопротивления всех полученных композитов в исследуемом диапазоне температур (рис. 3, *a*). При этом в композитах с высокой концентрацией углерода в области азотных температур



Рис. 3. Зависимости электрического сопротивления (a) и термоэдс (b) тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C от температуры в диапазоне 77–300 К. Около кривых указано содержание углерода в at.%.

электрическое сопротивление настолько высокое, что применяемыми приборами его измерить не удалось.

Температурные зависимости термоэдс имеют вид кривых с максимумом, высота которого растет с увеличением концентрации углерода (рис. 3, b).

4. Обсуждение результатов

Для установления механизмов электропереноса полученные зависимости электрического сопротивления от температуры были перестроены в координатах $\ln R \propto f(1/T^n)$ (где степень *n* принимала значения 1/4, 1/2, 1), $\ln R \propto f(\ln T)$ и $\ln R \propto f(\ln(1/T))$, а зависимости термоэдс — в координатах $S \propto f(\ln T)$, $S \propto f(1/T)$ и $S \propto f(T^{1/2})$.

Анализ полученных результатов удобно провести отдельно для образцов с концентрацией углерода больше 12 at.% и меньше 12 at.%.

Следуя описанной выше процедуре, удалось установить, что для образцов с концентрацией углерода выше 12 at.% температурные зависимости электросопротивления и термоэдс имеют линейный участок в координатах $\ln R \propto f(1/T)$ и $S \propto f(1/T)$ соответственно (рис. 4, *a* и *b*). Следовательно, температурную зависимость электрического сопротивления ρ исследованных нанокомпозитов в диапазоне температур 250–300 К можно описать уравнением Аррениуса [12,13]

$$\rho = \rho_0 \exp\left(-\frac{E_a^R}{2kT}\right),\tag{1}$$

где E_a^R — энергия активации электрической проводимости, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура.

При этом для температурной зависимости термоэдс в этой области температур должна быть справедлива формула [12–14]

$$S = \pm \frac{k}{c} \left(\frac{E_a^S}{kT} + A \right), \tag{2}$$

где *е* — заряд электрона, *А* — постоянная, E_a^S — энергия активации термоэдс.

По экспериментальным зависимостям (рис. 4, a и b) были определены значения энергии активации проводимости E_a^R и термоэдс E_a^S , которые приведены в табл. 1.



Рис. 4. Зависимости $\ln R \propto f(1/T)$ (*a*) и $S \propto f(1/T)$ (*b*) тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}—С с концентрацией углерода выше 12 at.%. Около кривых указано содержание углерода в at.%.

Таблица 1. Энергии активации проводимости и термоэдс, а также средняя энергия прыжка для тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-С в интервале температур 250-300 K

Концентрация углерода, at.%	E_a^R , eV	E_a^S , eV	W_h , eV
16.2	0.399	0.320	0.079
14.2	0.392	0.331	0.061
12.8	0.278	0.252	0.026

Как видно из табл. 1, значения энергии активации электропроводности и термоэдс различаются на некоторую величину W_h , уменьшающуюся с уменьшением содержания углерода в образцах. Согласно [12], данный факт может выступать в роли критерия определения прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям в хвосте локализованных состояний на краю зоны проводимости, тогда энергию W_h можно интерпретировать как энергию прыжка, а формулу (1) более корректно переписать в виде

$$\rho = \rho_0 \exp\left(-\frac{E_a^{R^*} + W_h}{2kT}\right),\tag{3}$$

где $E_a^{R^*} = E_a^S = E_A - E_F$, E_A — энергия на краю зоны проводимости, E_F — энергия Ферми. Отметим, что значения $E_a^{R^*}$ и E_a^S совпадают с вели-

Отметим, что значения $E_a^{R^*}$ и E_a^S совпадают с величинами энергии активации, рассчитанными для пленок чистого алмазоподобного аморфного углерода, полученного различными способами [15,16].

Согласно Мотту, энергия прыжка обратно пропорциональна плотности состояний на уровне Ферми. При уменьшении содержания углерода растет количество дефектов матрицы, что должно приводить к росту плотности локализованных состояний и, следовательно, к уменьшению W_h , что и происходит в данных композитах (табл. 1).

Для образцов с концентрацией углерода меньше 12 at.% на температурных зависимостях термоэдс можно выделить три участка, внутри каждого из которых S изменяется монотонно (рис. 3, b участки I, II и III).

Анализ полученных зависимостей показал, что в области 77–150 К температурная зависимость электрического сопротивления хорошо спрямляется в координатах $\ln R \propto f (1/T)^{1/4}$ (рис. 5, *a*), а нелинейный рост термоэдс с температурой подчиняется закону $T^{1/2}$ (рис. 5, *b*). Это свидетельствует о том, что неупорядоченная структура исследуемых композитов способствует проявлению прыжковой проводимости электронов с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям, лежащим в узкой полосе энергий вблизи уровня Ферми.

Тогда, согласно [12], выражение для проводимости имеет следующий вид

$$\sigma = e^2 r^2 \nu_{\rm ph} \, g \, \exp\left(-\frac{B}{T}\right)^{1/4},\tag{4}$$

где

$$B = \frac{16}{a^3 k g(E_{\rm F})},\tag{5}$$

r — длина прыжка, $v_{\rm ph}$ — фактор спектра фононов взаимодействия, $g(E_{\rm F})$ — плотность состояний на уровне Ферми, a — радиус локализации волновой функции электрона.

Из данных рис. 5, *а* были получены значения величин *В* для исследованных составов композитов. Зная *В* и предполагая, что процесс переноса носителей заряда лимитируется прыжками между нанокристалликами Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}, для оценки плотности локализованных состояний принимаем радиус локализации $a \approx 3.2$ nm (средний размер кристаллитов). Полученные значения плотности состояний на уровне Ферми для разных составов композитов представлены в табл. 2 и на рис. 6. При уменьшении концентрации углерода до значения порога протекания наблюдается увеличение плотности состояний на уровне Ферми (рис. 6). За порогом плотность состояний на уровне Ферми практически не зависит от концентрации С.



Рис. 5. Зависимость $\ln R \propto f(1/T^{-1/4})$ (*a*) и $S \propto f(T^{1/2})$ (*b*) тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C. Около кривых указано содержание углерода в at.%.

Концентрация углерода, at.%	Тангенс угла наклона	$B^{1/4}$, K ^{1/4}	В, К	Плотность локализованных состояний, 1/(eV · cm ³)	Средняя длина прыжка при 140 K, nm	$ \left(\frac{\partial \ln g(E)}{\partial E} \right)_{E=E_{\rm F}}, {\rm eV}^{-1} $ $ (T = 140 {\rm K}) $	$W_{\rm FRH}, { m eV}$ $(T=140{ m K})$
11.5	40.217	40.217	$2.616\cdot 10^6$	$2.164\cdot10^{18}$	14.03	1.477	0.141
10.8	23.98	23.98	$3.307\cdot 10^5$	$1.712\cdot 10^{19}$	8.366	6.231	0.084
10.3	11.173	11.173	$1.558\cdot 10^4$	$3.633 \cdot 10^{20}$	3.898	16.779	0.039
9.8	12.847	12.847	$2.724\cdot 10^4$	$2.078 \cdot 10^{20}$	4.482	20.496	0.045

Таблица 2. Параметры модели прыжковой проводимости электронов с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям, лежащим в узкой полосе энергий вблизи уровня Ферми для пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C

Проведем также оценку средней энергии прыжка, которая в случае прыжков с переменной длиной должна быть равна

$$W_{\rm VRH} = k(BT^3)^{1/4}.$$
 (6)

Если в интервале 77–150 К имеет место прыжковый механизм проводимости с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям, лежащим в узкой полосе энергий вблизи уровня Ферми, то для термоэдс должно быть справедливо выражение [12]

$$S = \frac{k^2}{2e} \sqrt{TB} \left(\frac{\partial \ln g(E)}{\partial E} \right)_{E=E_{\rm F}}.$$
 (7)

Учитывая полученные ранее значения *B* и *S* (табл. 2), можно оценить производные логарифма плотности локализованных состояний по энергии для различных температур. Результаты таких оценок для исследованных композитов при T = 140 К представлены в табл. 2.

Интересно, что асимптотика температурных зависимостей термоэдс для композитов, находящихся за порогом протекания, к $T \rightarrow 0$ не дает значения $S(T \rightarrow 0) = 0$. Данное обстоятельство указывает на то, что в области низких температур T < 80 К наблюдается проявление



Рис. 6. Зависимость плотности электронных состояний на уровне Ферми тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-С от концентрации углерода.

Таблица 3. Параметры модели прыжковой проводимости электронов по ближайшим соседям для пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C

Концентрация углерода, at.%	$ \left(\frac{\partial \ln g(E)}{\partial E} \right)_{E=E_{\rm F}}, {\rm eV}^{-1} \\ (T = 180 {\rm K}) $	W _{NNH} , eV	r_0, nm ($T = 180 \mathrm{K}$)
11.5	83.8	0.044	13.6
10.8	70.4	0.024	8.3
10.3	53.5	0.012	3.8
9.8	51.5	0.014	4.3

дополнительного механизма электропроводности и термоэдс.

Таким образом, учитывая приведенные выше аргументы, а также реалистичность и согласованность проведенных оценок модельных параметров, для исследованных композитов можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что прыжковый механизм электропереноса с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям в узкой полосе энергий на уровне Ферми является доминирующим в области температур 77–150 К.

Дальнейшее увеличение температуры приводит к отклонению зависимостей электросопротивления и термоэдс от выраженных формулами (4) и (7) соответственно. Тщательный анализ показал, что в области температур 150–210 К рост термоэдс с температурой происходит по линейному закону (рис. 7, *b*), а зависимость электросопротивления в данном интервале температур может быть описана прямой линией в координатах ln $R \propto f(1/T)$ (рис. 7, *a*).

Если рассматривать обозначенный температурный интервал как область реализации прыжковой проводимости по ближайшим соседям, то, согласно [12], для электросопротивления и термоэдс должны выполняться равенства

$$\rho = \rho_1 \exp\left(-\frac{W_{\rm NNH}}{kT}\right),\tag{8}$$

$$S = \frac{2\pi}{3} \frac{k^2 T}{e} \left(\frac{\partial}{\partial E} \ln g(E) \right)_{E=E_{\rm F}},\tag{9}$$



Рис. 7. Зависимости $\ln R \propto f(1/T)(a)$ и $S \propto f(T)(b)$ тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C с концентрацией углерода менее 12 at.% в области температур 120–240 К. Около кривых указано содержание углерода в at.%.

где *W*_{NNH} — энергия активации прыжка, задаваемая для прыжков по ближайшим соседям выражением

$$W_{\rm NNH} = \frac{3}{4\pi r_0^3 N(E_{\rm F})},$$
(10)

где r_0 — среднее расстояние между ближайшими соседями, $N(E_{\rm F})$ — плотность состояний на уровне Ферми.

Используя формулы (8) и (9), по данным рис. 7, *a* и *b* оценим значения энергии активации прыжка и производные логарифма плотности локализованных состояний. Результаты приведены в табл. 3.

Из табл. 2 и 3 видно, что при переходе от прыжкового механизма проводимости с переменной длиной прыжка к прыжковому по ближайшим соседям энергия активации прыжка уменьшается.

Поскольку проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям на уровне Ферми, установленная ранее, и проводимость по ближайшим соседям должны проходить внутри одной и той же узкой полосы энергий, считая, что плотность локализованных состояний не сильно зависит от температуры, на основе данных табл. 2 и формулы (10) можно оценить среднее расстояние между ближайшими соседями.

Сравнение данных табл. 2 и 3 приводит к следующим выводам.

1. Средняя длина прыжка при прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка согласуется с расстояниями между ближайшими соседями, рассчитанными для прыжковой проводимости по ближайшим соседям.

2. Значения энергий активации прыжка уменьшаются при переходе от прыжкового механизма проводимости с переменной длиной прыжка к прыжковому по ближайшим соседям.

3. Значения производных логарифма плотности локализованных состояний по энергии на уровне Ферми увеличиваются с повышением температуры, что может свидетельствовать либо об изменении распределения плотности состояний по энергиям с температурой, либо о смещении уровня Ферми в области локализованных состояний.

Кроме того, если считать, что при прыжках по ближайшим соседям ширина зоны локализованных состояний, лежащих около уровня Ферми, приблизительно равна удвоенной энергии активации прыжка, из табл. 3



Рис. 8. Зависимость $\ln R \propto f(1/T)$ (*a*) и $S \propto f(1/T)$ (*b*) тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-С в области температур 250-286 К. Около кривых указано содержание углерода в at.%.



Рис. 9. Зависимость $\ln R \propto f(1/T)$ (*a*) и $S \propto f(1/T)$ (*b*) тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-С в области температру 290-305 K. Около кривых указано содержание углерода в at.%.

следует, что с добавлением углерода ширина этой зоны увеличивается.

Наличие линейного характера зависимости $\ln R \propto f(1/T)$ в диапазоне температур 240–286 К свидетельствует о термоактивируемом механизме переноса (рис. 8, *a*). Кроме того, при температурах выше 240 К зависимость для термоэдс имеет вид прямой линии в координатах $S \propto f(1/T)$ (рис. 8, *b*), что подтверждает термоактивируемый механизм электропереноса.

Следовательно, температурные зависимости электрического сопротивления и термоэдс также должны описываться уравнениями (1), (2).

По экспериментальным зависимостям $\ln R \propto f(1/T)$ и $S \propto f(1/T)$ (рис. 8, *a* и *b*) были определены значения энергии активации проводимости E_a^R и термоэдс E_a^S , которые приведены в табл. 4.

Энергии активации проводимости E_a^R и термоэдс E_a^S не совпадают, при этом $E_a^R > E_a^S$, как и в случае образцов с концентрацией углерода более 12 аt.%. Таким образом, прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям в хвосте локализованных состояний на краю зоны проводимости также является доминирующим механизмом электропереноса в образцах с концентрацией углерода менее 12 аt.% при температурах 240–286 К. Так же как и ранее, произведем оценку энергии прыжка. Из табл. 4 видно, что для образцов за порогом протекания (< 10.5 at.%. С) энергия прыжка на порядок меньше, чем для образцов до порога протекания. При дальнейшем увеличении температуры на экспериментальных зависимостях $\ln R \propto f(1/T)$ и $S \propto f(1/T)$ (рис. 9, *a* и *b*) был обнаружен излом, свидетельствующий о смене доминирующего механизма электропереноса. Анализ показал, что в области температур 290–300 К

Таблица 4. Энергии активации проводимости и термоэдс, а также средняя энергия прыжка для тонких пленок Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-С в области температур 240-286 К

Концентрация углерода, at.%	E_a^R , eV	E_a^S , eV	W_h , eV
11.5	0.134	0.119	0.015
10.8	0.0622	0.0434	0.0188
10.3	0.0346	0.0331	0.0015
9.8	0.03996	0.0386	0.00136

Таблица 5. Энергии активации проводимости и термоэдс тонких пленок $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C$ в области температур 290–300 К

Концентрация углерода, at.%	E_a^R , eV	E_a^s , eV
10.8 10.3 9.8	$\begin{array}{c} 0.0760 \pm 0.005 \\ 0.0368 \pm 0.005 \\ 0.0456 \pm 0.005 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.0762 \pm 0.005 \\ 0.0366 \pm 0.005 \\ 0.0452 \pm 0.005 \end{array}$

полученные зависимости являются активационными и могут описываться уравнениями (1) и (2). Значения энергии активации проводимости E_a^R и термоэдс E_a^S , рассчитанные по данным рис. 9, *a* и *b*, приведены в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что энергии активации проводимости E_a^R и термоэдс E_a^S совпадают с точностью до погрешности измерения. Следовательно, в диапазоне температур 290–300 К реализуется перенос носителей заряда, возбужденных за край подвижности в нелокализованные состояния, а выражения для электропроводности и термоэдс могут быть заданы в виде

$$\rho = \rho_2 \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right),\tag{11}$$

$$S = -\frac{k}{e} \left(\frac{E_C - E_F}{kT} + A \right), \tag{12}$$

где *E*_C — энергия на краю подвижности.

Таким образом, в исследованных композитах в различных температурных интервалах реализуются разные механизмы проводимости, что сопровождается изменением температурных зависимостей электрического сопротивления и термоэдс.

5. Выводы

1. Методом ионно-лучевого распыления составной мишени в атмосфере аргона синтезированы тонкопленочные образцы полупроводникового твердого раствора $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}$ с углеродом. Методами рентгеновской и электронной дифракции, а также просвечивающей электронной микроскопии установлено, что синтезированные пленки $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C$ являются наноструктурированными. Показано, что добавление углерода в твердый раствор $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C$ являютк подавлению роста кристаллитов и снижению анизотропности тонких пленок $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C$.

2. Исследования концентрационных зависимостей удельного электрического сопротивления тонких пленок $Sb_{0.9}Bi_{1.1}Te_{2.9}Se_{0.1}-C$ показали, что они имеют вид *S*-образных кривых, типичный для перколяционных систем (рис. 2, *a*).

3. Исследования низкотемпературных зависимостей электрического сопротивления и термоэдс в области температур 77–300 К показали последовательную смену доминирующих механизмов проводимости: прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям, лежащим в узкой полосе энергий вблизи уровня Ферми, при температурах 77–150 К, прыжковая проводимость по ближайшим соседям при температурах 150–210 К, прыжковый механизм электропереноса с переменной длиной прыжка в хвосте локализованных состояний на краю зоны проводимости при температурах, близких к комнатным, сменяющийся

для образцов за порогом протекания переносом носителей заряда, возбужденных за край подвижности в нелокализованные состояния.

Список литературы

- [1] Г. Голдсмид. Применение термоэлектричества. Физматлит, М. (1963). 320 с.
- [2] D.M. Rowe. CRC handbook of thermoelectrics. CRC Press, Boca Raton, London–N.Y.–Washington (1995). 701 p.
- [3] Б.С. Поздняков, Е.А. Коптелов. Термоэлектрическая энергетика. Атомиздат, М. (1974). 264 с.
- [4] Г.А. Громов. Компоненты и технологии 158, 87 (2014).
- [5] Б.М. Гольцман, З.М. Дашевский, В.И. Кайданов, Н.В. Коломоец. Пленочные термоэлементы: физика и применение. Наука, М. (1985). 119 с.
- [6] А.Ф. Иоффе. Полупроводниковые термоэлементы. Изд-во АН СССР, М. (1960). 188 с.
- [7] K.R. Stevens, M.G. Kanatzidis, S. Johnsen, S.N. Girard. Nanoscape 7, 52 (2010).
- [8] Л.П. Булат, И.А. Драбкин, В.В. Каратаев. ФТТ 52, 1712 (2010).
- [9] Л.П. Булат, В.В. Освенский, Ю.Н. Пархоменко, Д.А. Пшенай-Северин. ФТТ 54, 20 (2012).
- [10] А.А. Снарский, А.К. Сарычев, И.В. Безсуднов, А.Н. Лагарьков. ФТП **46**, 677 (2012).
- [11] L.M. Goncalvesa, P. Alpuimb, G. Minc, D.M. Rowec, C. Coutoa, J.H. Correia. Vacuum 82, 1499 (2008).
- [12] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1982). 658 с.
- [13] О.Е. Парфенов, Ф.А. Шклярук. ФТП **41**, *9*, 1041 (2007).
- [14] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников. Наука, М. (1979). 416 с.
- [15] J. Robertson. Mater. Sci. Eng. R 37, 129 (2002).
- [16] J. Robertson. Mater. Sci. Forum 52, 125 (1989).